

性能表

HDRA\_08

品名	HDRA型コネクタ RoHS対応品		製品番号	HDRA-E68W( )LFD( ) ( ) ( ) - ( ) +	
定格	電圧	AC 30V		コネクタ 適合	HDRA-E68M( )1+
	電流	0.3A			適合ケース
	温度	動作温度:-55°C~85°C 保存温度:-55°C~85°C			
	湿度	相対湿度 95%以下			
			引用規格	ANSI-SFF 8441	

特 性

No.	項目	条件	認定試験	製品検査	
1	外観・構造・仕上	JIS C 5402 4.1 項により付図及び引用規格に適合すること。	○	○	
2	寸法	同上 4.2 項により 同上	○	○	
3	表示	同上 4.4 項により 同上	○	○	
4	絶縁抵抗	EIA 364-21より DC 100 V で測定したとき 500 MΩ 以上	○	-	
5	耐電圧	EIA 364-20より AC 250 V (実効値) を1分間印加して絶縁破壊のないこと。	○	-	
6	接触抵抗	EIA 364-23より YHP 4328 A にて測定して 100 mΩ 以下	○	-	
7	抜去力 及び 挿入力	コネクタ外単体 テストピン	挿入力 : 1.47 N 以下	○	-
			抜去力 : 0.294 N 以上	○	-
		組立品総合 現物嵌合	挿入力 : 54.88 N 以下	○	-
			抜去力 : 14.7 N 以上	○	-
8	繰り返し動作	EIA 364-09により 挿抜 2000回で試験後 接触抵抗 は120mΩ以下。	○	-	
9	耐振性	EIA 364-28により 最大加速度 98m/s <sup>2</sup> 、周波数 10-500Hz、掃引時間 15 分 1 方向 12サイクルで X、Y、Z方向 計36サイクル、合計9時間で試験後、割れやゆるみがないこと。瞬断は1μs以下。	○	-	
10	耐衝撃性	EIA 364-27により 加速度 294 m/s <sup>2</sup> 、X、Y、Z方向 各3 回で試験後、割れやゆるみがないこと。瞬断は1μs以下。接触抵抗 120mΩ以下。	○	-	
11	耐湿性	EIA 364-31により 最高温度 65°C、最低温度 -10°C、湿度 90~98%RH、10サイクルで試験後割れ等の異常のないこと。接触抵抗 120mΩ以下。	○	-	
12	熱衝撃性	-55°C/30 分間~ +25°C/5分以内~ +65°C/30 分間~ +25°C/5分以内を1サイクルとして、25サイクルで試験後割れ等の異常のないこと。接触抵抗 120mΩ以下。	○	-	
13	高温放置	EIA 364-17により 温度 85 °C、時間 500時間で試験後、接触抵抗は 120mΩ以下	○	-	
14	混合ガス	EIA 364-65により 温度 30°C、湿度 70%、Cl <sub>2</sub> 20±5ppb、NO <sub>2</sub> 200±50ppb、H <sub>2</sub> S 200±20ppb 時間 20日間で試験後 はなはだしい腐食が無いこと。接触抵抗 120mΩ以下。	○	-	
15	塩水噴霧	EIA 364-26により 5% 塩水、温度 35°C 時間 48時間 試験後 はなはだしい腐食が無いこと。接触抵抗 120mΩ以下。	○	-	
16	耐溶剤性	MIL-STD-202F 試験法215Eによりイソプロピルアルコールにて洗浄したとき、外観上損傷がないこと。浸漬時間 30±5sec.	○	-	
17	はんだ濡れ性	250±3°C、3sec. で試験したとき、はんだ濡れ性が95%以上のこと。	○	-	
18	はんだ耐熱性	リフロー半田法: ピーク 250°C、10sec. (220°C、60sec.) 半田槽法: 260 ±5 °C 浸せき時間 10±1 sec. 半田こて法: 390±5°C 時間 4~5sec. 試験後、熱的損傷がないこと。	○	-	
注意事項		<p>○半田付作業について 推奨値</p> <p>リフロー : ピーク : 240~250°C、10sec. 未満 半田付け : 220°C、30~60sec. プリヒート : 150~180°C、90~120sec. 回数 : 2回まで。</p> <p>手半田 : 380±10°Cのコテで4秒以下とし、コテ先でコンタクトに負荷を与えないこと。回数 : 2回まで。 フロー : 260±3°C 浸漬時間 5 +1/-0 sec. 回数 : 2回まで。</p> <p>○接触部に接触の障害となる様な負荷をかけないこと。また異物をいれないこと。 ○製品を変形させる様な負荷を与えないこと。</p>			

承認		検図		検図	-	作成	
△	年月日	変更者	変更内容	承認	本多通信工業株式会社		作成 2005年 10月 18日